

製品・技術 PR レポート

1. 企業概要

会社名	サワダSTB株式会社			代表者名	澤田均		
				窓口担当	天野智行		
事業内容	試験ソフト開発、半導体チップ加工			URL	http://www.sawada-stb.co.jp		
主要製品	実装基板用テストプログラム開発・フィクスチャー製造販売、半導体ウエハー研磨・切削加工						
住所	東京都青梅市二俣尾3丁目841番地						
電話番号	0428-78-8402			FAX 番号	0428-78-9000		
資本金(M¥)	48	設立年月日	昭和 39 年 7 月	売上(M¥)	1,800	従業員数	95

2. PR事項

『実装基板テストソリューション』

●新製品開発企画段階から提案しています

■ソフトウェア（テストプログラム）

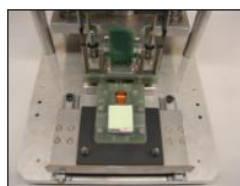
- ◎大型汎用デジタルインサーキットテストプログラム開発
- ◎アナログインサーキットテストプログラム開発
- ◎パソコンを用いた個別ファンクションプログラム開発
- ◎SHマイコン等を用いたファンクションプログラム開発

当社所有の大型汎用
インサーキットテス
ター（仕様に応じて
8台有ります）



■ハードウェア（テストフィクスチャー）

- 狭ピッチコンタクトフィクスチャー（0.4mmピッチ）
（0.4mm以下のピッチも応談可）



- 120℃から-5℃まで温度
環境対応フィクスチャー



その他、当社のノウハウを活用したテストフィクスチャーはお客様の個別ニーズに対応します。

- サイドコンタクト治具
基板上のコネクタにワンアクションで上下左右から直接接続する。コネクタ脱着効率向上、無洗浄基板への安定コンタクトが得られます。
- 親治具・子治具タイプハンドプレス治具
アタッチメント方式で収納／省スペースを実現。経済性を追求しました。

『ウエハー等の研磨・切削等微細加工』

●ウエハー微細加工へのチャレンジ部門

前工程が終了したウエハーの裏面研磨（バックグラインド）、切削（ダイシング）、レーザーマーキング、バンプ加工、及び分散したチップのトレー詰め、テーピング加工等あらゆる加工に対して、最新設備とノウハウを蓄積した社内検査体制で、満足度を追及していきます。

■我社の加工を支える設備群

- バックグラインドでは25μmまでの加工が可能（試作段階では15μmまで）



- ダイシングはシリコンウエハー以外にもガラス、セラミック、PCB樹脂等の対応も可能



- BUMP ボンダー工程
6インチ、8インチ標準対応でウエハー状態でのスタット BUMP 対応可能
レベリング工程無しで安定した高さの BUMP 対応可能

